

Jeringa de 10 cc de pasta para soldar (FLUX)

Codigo: **112010**



Descripción

Fundente de alta viscosidad sin limpieza, se puede usar para PCB, BGA, PGA y puede ser utilizado para soldar y reballing de chips de computadora y teléfono, es la mezcla de polvo aleado de alta calidad y fundente pastoso, puede evitar el residuo amarillo pálido, por lo que es fácil limpiar el tablero.

- Tipo: YX-223
- Alta Intensidad Conjunta
- Buena inmersión
- Volumen: 10 ml / 10cc
- Dimensión: 95 × 35 × 23 mm